

# DUKSAN HI-METAL

Investor Relations 2022

The 1st INNO-Creator via Unlimited Challenge

# Disclaimer

본 자료에 기술되어 있는 2022년 1분기 실적은 K-IFRS 기준의 내용이며, 투자자들에게 정보 제공을 목적으로 덕산홀딩스(주)(이하 회사)에서 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드립니다.

또한 본 자료는 미래의 불확실성 및 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 가정에 근거한 특정 정보를 포함하고 있습니다. 이는 세계 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 전략 및 사업 계획 등의 미래 투자 계획을 포함합니다. 이러한 가정과 환경의 변화로 인한 변동 사항에 대하여는 당사의 책임이 없음을 양지하시길 바랍니다.

회사의 실제 실적은 당사가 예측하지 못할 수 있는 요소들로 인해 변경될 수 있습니다. 이러한 요소는 경제 침체의 심화, 고객 수요의 감소, 주요 고객의 이탈, 가격 하락 압박, 특정 프로젝트 및 설비투자에 대한 자금 조달 상의 문제 등을 포함합니다.

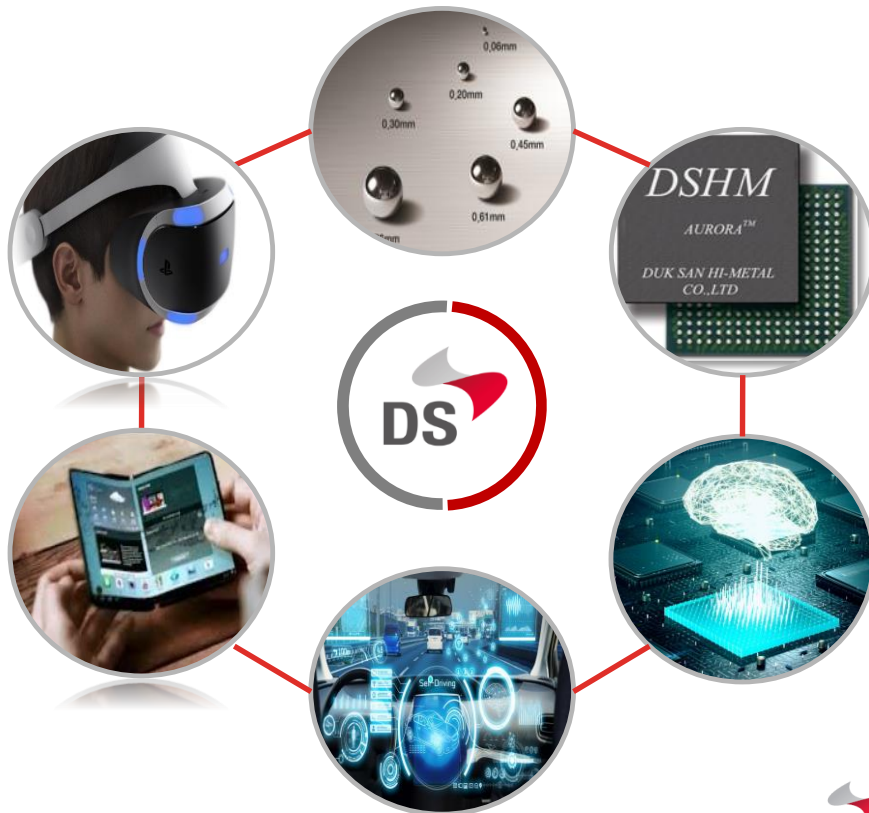
본 자료에 포함된 재무 정보는 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 감사 후 실제 실적에는 변동이 생길 수 있음을 양지하시길 바랍니다.

# 01. COMPANY IDENTITY

The 1st INNO-Creator via Unlimited Challenge

소재업계 세계 선두주자

4차산업혁명 소재 부품 기술의  
소재 산업 업계의 선두주자



Vision

비전

꿈임없이 도전하는 소재·부품  
1st INNO-Creator

핵심  
가치

- 기술'을 통한 '미래'의 창조
- '감동'을 통한 '고객'의 행복
- '책임'을 통한 '사회'의 발전
- '나'를 통한 '우리'의 실현

경영  
방침

- 공감 경영, 책임경영
- 신뢰 경영, 기술경영
- 프로세스 경영

## 02. COMPANY OUTLINE

|      |                  |      |                          |
|------|------------------|------|--------------------------|
| 기업명  | 덕산하이메탈㈜          | 사업분야 | 반도체 부품소재 제조 및 판매, 사업지주회사 |
| 대표이사 | 이수훈, 김윤철(각자대표이사) | 임직원수 | 237명(2022년 03월 31일 기준)   |
| 자본금  | 9,087 백만원        | 주소   | 울산광역시 북구 무룡1로 66         |
| 설립일  | 1999년 05월 06일    | 홈페이지 | www.dshm.co.kr           |

## President

## 주요 임원진



## 會長 이 준 호

- 부산대학교 경제학과
- 前 현대중공업, 현대정공
- 덕산산업 설립(1982)
- 덕산하이메탈 설립(1999)
- 前 덕산하이메탈 대표이사
- 前 덕산네오룩스 대표이사
- 現 덕산홀딩스 대표이사
- 現 덕산그룹 회장

| 직 책           | 성 명   | 주요경력                                                                                                               |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부회장<br>(대표이사) | 이 수 훈 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 고려대학교 국제대학원 석사</li> <li>▪ 덕산네오룩스 대표이사(兼)</li> <li>▪ 現 덕산그룹 부회장</li> </ul> |
| 부회장<br>(대표이사) | 김 윤 철 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 덕산홀딩스 사장(兼)</li> <li>▪ 現 덕산그룹 부회장</li> </ul>                              |
| 사장            | 이 금 덕 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 국민대학교 졸업</li> <li>▪ 덕산하이메탈 CMO</li> </ul>                                 |

# 03. HISTORY

## 설립기

### 기술개발 및 거래처 확대

1999. **DSHM 설립**, ISO 9002 인증  
삼성전자, Hynix 협력사 등록

2000. **석탑산업훈장 수훈**  
ChipPAC, ASE 품질승인, 업체등록

2001. Amkor Korea, 필립스 등 품질승인, 업체등록

2002. **덕산하이메탈 기술연구소 설립**  
솔더볼에 대한 특허 4건 등록

2003. 솔더볼에 대한 특허 2건 등록

2004. **덕산하이메탈 신축공장 완공 / 이전**  
**한국산업안전공단 CLEAN 사업장 선정**

## 성장기

### 생산 능력 확대 및 생산성 증대

2005. **코스닥 신규 상장(KQ 077360)**  
ISO 14001 인증, 세계일류상품 선정

2006. **유미코어(벨기에) 투자조인식 체결**

2006. 제43회 천만불 수출탑 수상

2008. 기술혁신형 중소기업(INNOBIZ)  
제7회 100대 우수특허제품 대상(중소기업청)

2009. 루디스 흡수합병, 천안공장 준공

2011. 제45회 5천만불 수출탑 수상

2012. **World Class 300 기업 선정(지경부)**

2014. **N-E-X-T 2020 비전 선포식**

2014. 기업분할(DSHM / DSNL) 결정

## 도약기

### 사업 재정비 및 장기비전 수립

2015. **DSHM 재상장(KOSDAQ - 077360)**  
**DSNL 신규상장(KOSDAQ -213420)**

2015. **사업지주회사 전환(공정위)**

2016. **주요종속회사 덕산유엠티 해산(11/09)**  
**덕산테크피아로 흡수합병**

2016. **벤처활성화 유공포상(대통령상)**

2018. **사업지주회사→ 사업회사 전환(공정위)**

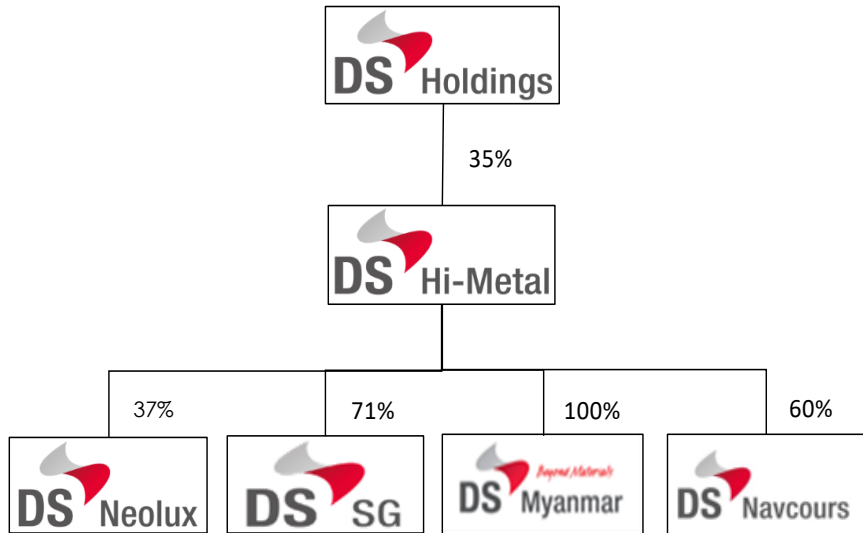
2019. **DS미얀마 설립**

2020. **CP 양산공급 개시**

2021. **넵코어스(주) 인수 완료(60%)**

# 04. GOVERNANCE

## Company Structure

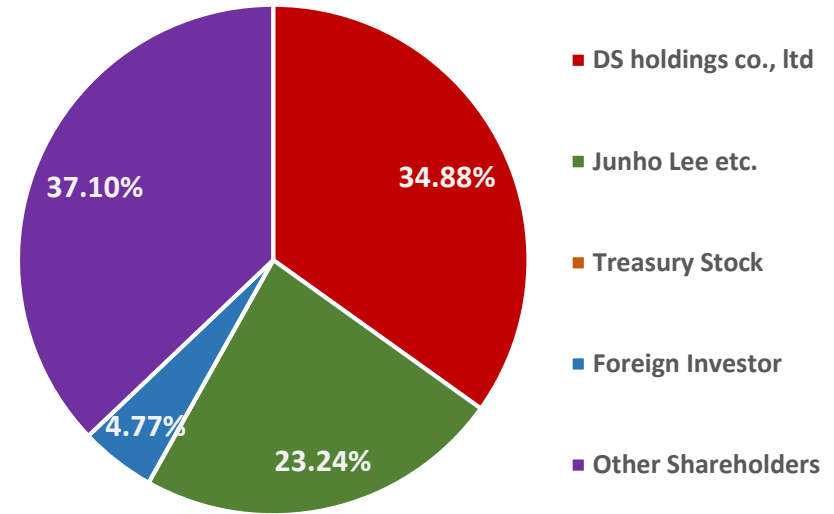


단위 : 억

| 자회사구분      | 연결여부  | 지분율  | 21년 매출액 | 21년 OP |
|------------|-------|------|---------|--------|
| 덕산네오룩스     | 지분법이익 | 37%  | 1,914   | 510    |
| 덕산넵코어스     | 연결자회사 | 60%  | 307     | 2      |
| DS Myanmar | 연결자회사 | 100% | 14      | (9)    |
| 덕산에스지      | 연결자회사 | 71%  | 중단      | 중단     |

## Shareholder Information

※ 2022. 03. 31



| 발행가능 주식수    | 80,000,000 shares |         |      |
|-------------|-------------------|---------|------|
| 덕산홀딩스(주)    | 7,924,924         | 34.88%  | 최대주주 |
| 이준호 외 특수관계인 | 5,280,277         | 23.24%  |      |
| 자기주식        | 0                 | 0.00%   |      |
| 외국인         | 1,084,372         | 4.77%   |      |
| 국내기관 및 기타   | 8,428,928         | 37.10%  |      |
| Total       | 22,718,501        | 100.00% |      |

# 05. SOLDER BALL PRODUCTS

## 반도체 패키징 핵심 부품소재

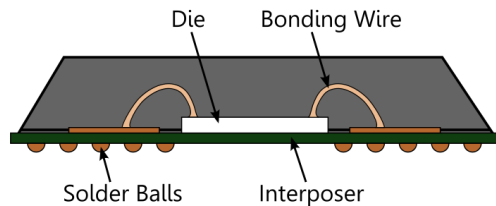
반도체의 소형화, 집적화에 따른 첨단 패키징(BGA, CSP, Flip Chip)의 핵심 부품 소재로 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 접합 소재

### SB

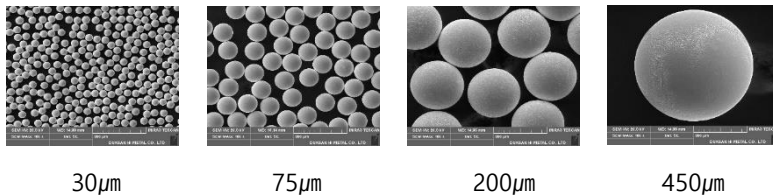
#### Solder Ball

40~760 $\mu$ m for BGA, CSP, Flip-Chip

BGA Package Sideview



#### <제품사진>



### MSB

#### Micro Solder Ball

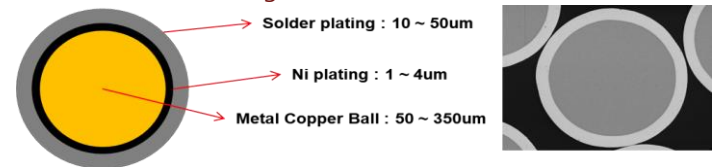
130 $\mu$ m 미만의 초정밀 솔더볼



### CSB

#### Cored Solder Ball

Substrate와 Chip간의 Bump 형성, 신호전달 및 Bump 형성 시 Height를 균일하게 유지하는 역할



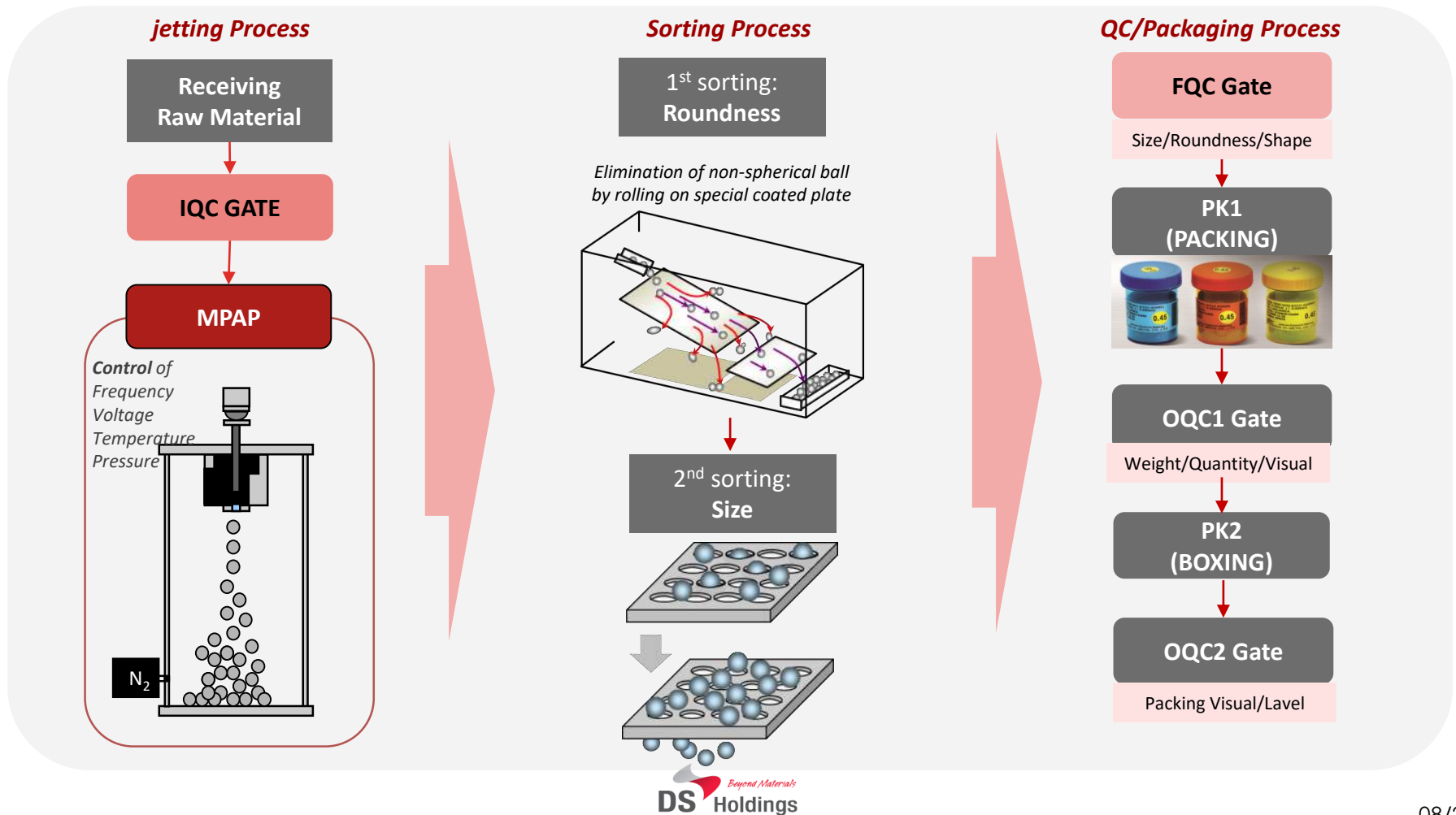
# 06. SOLDER BALL M/F PROCESS (PAP)

## 자체 개발 PAP공법과 자동화 시스템

### ➤ Pulsated Atomization Process

### Process

※SB(SB,MSB,CSB) Capacity : 14억K/Mon





# 07. NEW BUSINESS(CP)

**Conductive Particle(Ball) :** ACF 내의 디스플레이 패널(반도체 회로부)과 PCB를 전기적으로 연결 시키는 소재

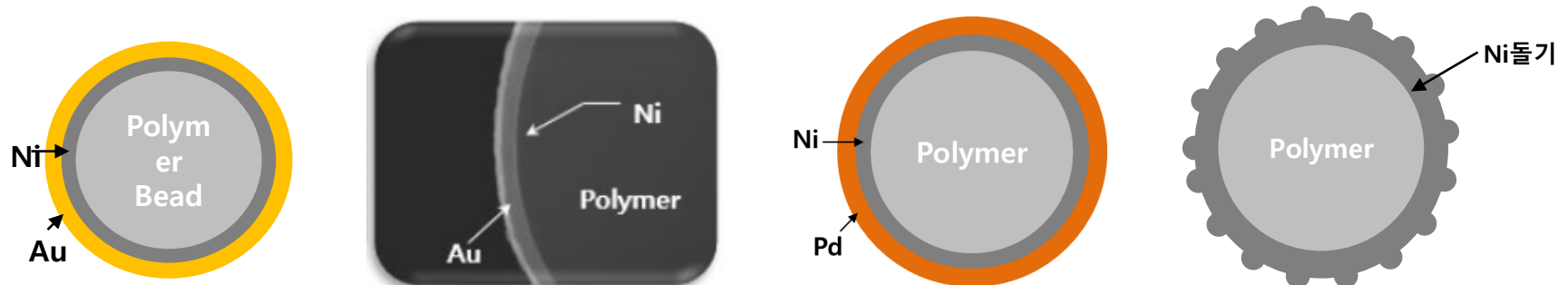
## ■ 이방도전성 접착필름(ACF : Anisotropic Conductive Film)

- 도전입자가 접착필름에 분산되어 패널과 칩 또는 PCB간에서 한쪽 방향으로만 접속하여 필요한 부분에만 전류가 통하도록 하는 **도전성 접착필름**



## ■ 도전볼(Conductive Ball)

- 고분자 비드(Polymer Bead) 외곽에 **금속이 무전해 도금되어 있는 볼**

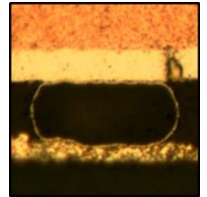


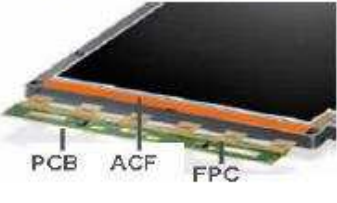
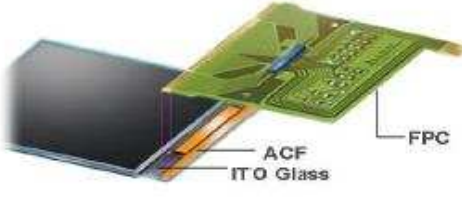
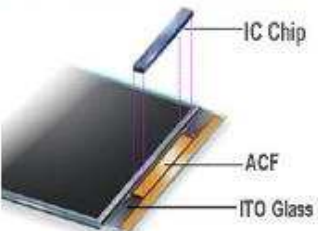
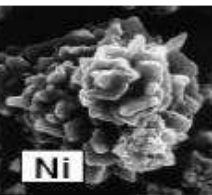
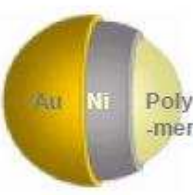
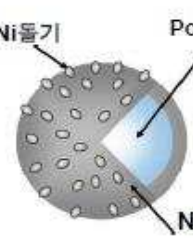
도전볼(Size: 3~30 $\mu$ m)

# 08. NEW BUSINESS(CP)

## ■ ACF용 도전입자(Conductive particle)

- 고분자 미립자코어, 도전막, 절연미립자를 자체 생산 및 개발 기술을 통한 고객 요구 사양에 최적화 가능
- \* **미립자코어** (피착제의 접착시, 전극손상을 줄이는 완충작용의 기능): 응용처에 따른 다양한 물성의 미립자 보유
- \* **도전막**(피착제 간 전류를 흐르게 하는 기능): 도금기술, 돌기입자 형성 기술
- \* **절연층**(미세피치에서 단락에 의한 도전불 간 전류가 흐르는 것을 방지하는 기능): 절연미립자 Size 조정 기술 및 제품
  - ▶ 응용처별 다양한 열과 압력에서 벗겨질 수 있도록 하여 전극에서는 통전 기능 수행



| 종류  | <div> <div>□ FOB (Film on Board)</div> <div>※ PCB用 ACF</div>  <div>PCB ACF FPC</div> <div>- 대형 LCD의 D-IC의 Tape과 PCB를 연결</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div> <div>□ OLB (Outer-Lead Bonding)</div> <div>※ Glass用 ACF</div>  <div>PCB ACF FPC</div> <div>- 대형 LCD의 ITO Glass와 D-IC를 연결</div> </div> | <div> <div>□ FOG (Film on Glass)</div>  <div>ACF ITO Glass FPC</div> <div>- Mobile용 LCD의 ITO Glass와 FPC를 연결</div> </div> | <div> <div>□ COG (Chip on Glass)</div>  <div>IC Chip ACF ITO Glass</div> <div>- ITO Glass와 Chip을 직접 연결</div> </div> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 도전불 | <div>  <div>Core : Ni<br/>무정형 Powder<br/>2~10 um</div> </div> <div>  <div>Core: Polymer<br/>도전막: Ni/Au<br/>3~20um</div> </div> <div>  <div>Core: Polymer<br/>도전막: Ni/Au</div> </div> <div>  <div>Core: Polymer<br/>도전막: Ni<br/>절연막: Polymer</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |

# 09. NEW BUSINESS(P&F)

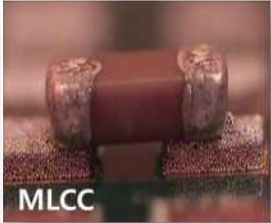
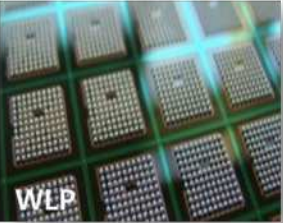
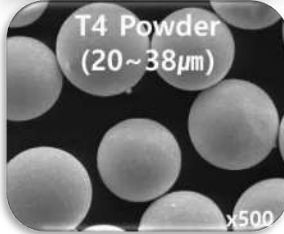
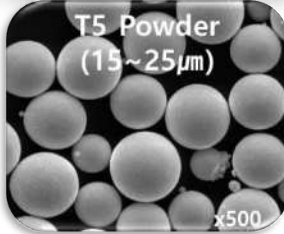
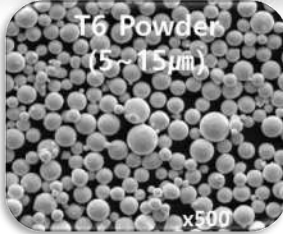
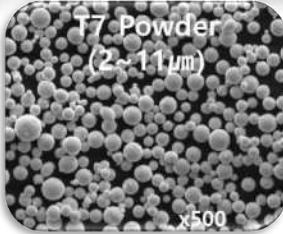
**Solder Paste : Flux와 Powder 형태의 합금(T4~T7)을 혼합한 크림 형태의 접합용 소재**

## SMT用

기판과 디바이스의 접합 및  
접촉면의 산화 방지 역할

## Bumping用

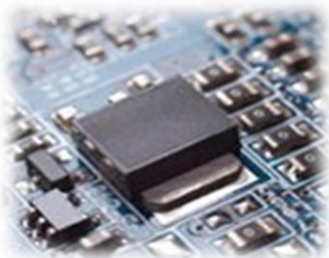
Solder Ball 대체용으로  
bump 형성 및 pre-solder 역할

|              | SMT Package                                                                                                         |                                                                                                                      | Bumping用                                                                                                             |                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paste<br>종류  | <br>MLCC                           |                                    | <br>PCB                           | <br>WLP                           |
| Powder<br>종류 | <br>T4 Powder<br>(20~38μm)<br>x500 | <br>T5 Powder<br>(15~25μm)<br>x500 | <br>T6 Powder<br>(5~15μm)<br>x500 | <br>T7 Powder<br>(2~11μm)<br>x500 |

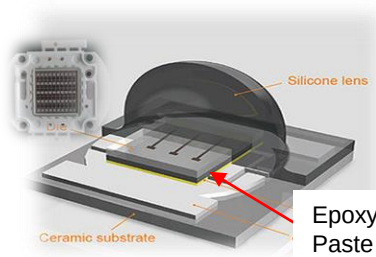
## Solder Paste 제품

### Type 4~5 Paste

☐ SMT : chip bonding用

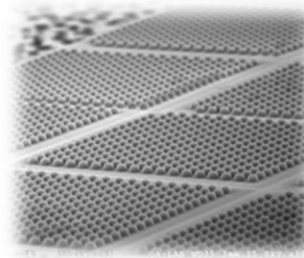


☐ LED module : LED 접합용

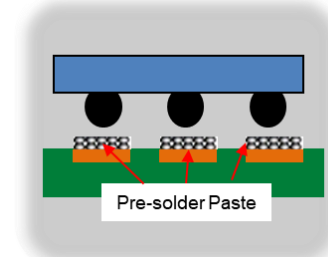


### Type 6~7 Paste

☐ 반도체 Package : Bumping用



☐ ETC : Pre-solder





# 10. NEW BUSINESS(P&F)

**Flux : 기판과 Solder 사이에 반응을 촉진시켜 주는 액상형태의 접합용 소재**

## 화학적

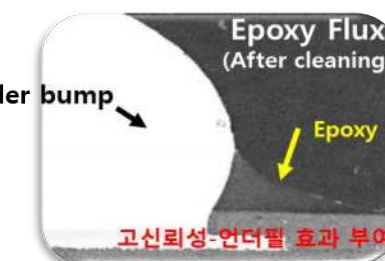
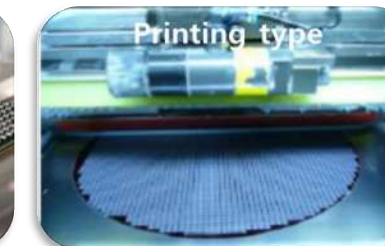
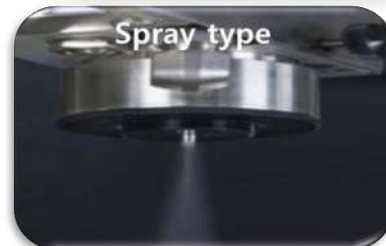
Solder & 기판의 산화막 제거 및 재산화 방지

## 물리적

Solder의 Wet Ability를 높임

## 열적

Solder와 PAD 간의 Solder-ability를 높임

|                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Flux 종류</p> | <p>Normal Flux<br/>(After cleaning)</p>  <p>No residue</p> | <p>Epoxy Flux<br/>(After cleaning)</p>  <p>Solder bump</p> <p>Epoxy</p> <p>고신뢰성-언더필 효과 부여</p> | <p>제품종류</p>        |
| <p>작업방법</p>    | <p>Dotting Type</p>                                        | <p>Printing type</p>                                                                          | <p>Spray type</p>  |

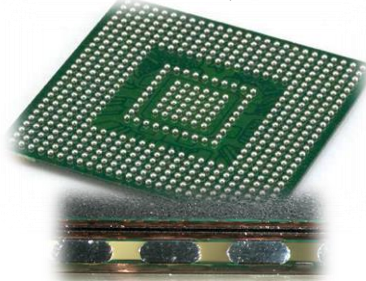
### ☐ SMT

※ chip bonding用



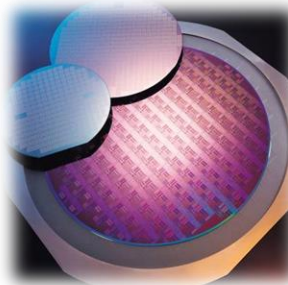
### ☐ BGA(Ball Grid Array)

※ Ball attach用 Flux



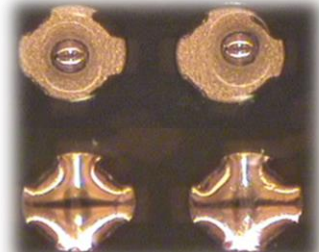
### ☐ WLP(wafer Level package)

※ Bumping用 flux



### ☐ ETC

※ High wetting flux



# 11. NEW BUSINESS(NAVCOURS)

|     |           |       |                      |
|-----|-----------|-------|----------------------|
| 기업명 | 넵코어스 주식회사 | 사업분야  | 방위산업/우주항공/PNT개발 및 제조 |
| 자본금 | 81.8억원    | 주소    | 대전광역시 유성구 테크노2로 66-6 |
| 설립일 | 2012년 12월 | 지분취득일 | 2021년 3월(59.97%)     |

## History



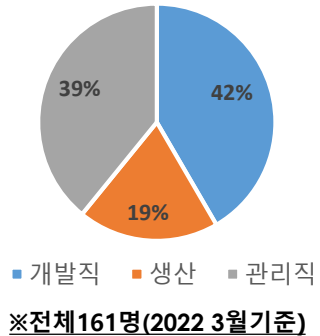
2012. 설립  
**2013. 방산업체지정(지식경제부)**  
 2014. 계측용 위성항법장치수주(국방과학연구소)  
 첨단기술제품 확인(산업통상자원부)
- 2015. AS9100 우주항공 품질경영시스템 인증(Lloyd)**
2016. 우수방산업체 국방부장관상수상(우수기술부문)  
 2017. 우수방산업체 방위사업청장상수상
- 2018. ESD정전기 인증획득(ANSI/ESD 520.20-2014)**  
**NADCAP 국제인증획득(PBA분야 국내최초)**  
 국방품질인증체계(DQMS)획득  
 누리호 시험발사체 성공(나로호우주센터)
- 2021. 덕산하이메탈(주) 피인수(60%)**

## 주요 사업분야

|       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 방위산업  |     |     |    |    |  |  |
|       | 감시정찰/센서                                                                              | 지휘통제통신                                                                                | 기동/지상무기                                                                               | 함정/해상무기                                                                               | 항공/전자                                                                               | 화력/유도무기                                                                             |
| 항공우주  |    |    |    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|       | 한국형위성발사체 분야                                                                          | 위성통신 분야                                                                               | 무인기/항공기용 항공전자 분야                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 항법인프라 |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|       | 이동통신&네트워크                                                                            | 전력보호계통                                                                                | SW 수신기                                                                                | 위성통신시스템                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |

# 12. NEW BUSINESS(NAVCOURS)

## 연구개발 인력



## Certification

- 항공우주 품질경영(AS9100)
- 항공우주/방산 상호인증(NADCAP)
- 군수/방산품 품질 적격(DQMS)
- 방산업체지정

## 재무상태표

KRWmn

|           | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| [유동자산]    | 20,673       | 21,990       | 24,641       |
| [비유동자산]   | 16,052       | 13,998       | 15,014       |
| 자산총계      | 36,725       | 35,988       | 39,655       |
| [유동부채]    | 10,585       | 11,523       | 15,387       |
| [비유동부채]   | 1,239        | 3,512        | 3,852        |
| 부채총계      | 11,824       | 15,035       | 19,239       |
| [자본금]     | 8,180        | 7,680        | 7,680        |
| [자본잉여금]   | 2,248        | 248          | 248          |
| [이익잉여금]   | 14,380       | 13,396       | 13,071       |
| [기타자본항목]  | 93           | (371)        | (583)        |
| 자본총계      | 24,901       | 20,953       | 20,416       |
| 부채 및 자본총계 | 36,725       | 35,988       | 39,655       |

## 최근 3개년 손익요약

KRWmn

|        | 2021년  | 2020년  | 2019년  |
|--------|--------|--------|--------|
| 매출액    | 30,660 | 37,464 | 34,569 |
| 영업이익   | 202    | 1,503  | 4,444  |
| 영업이익률  | 0.66%  | 4.01%  | 12.86% |
| 당기순이익  | 983    | 553    | 3,847  |
| 당기순이익률 | 3.21%  | 1.48%  | 11.13% |

# 13. NEW BUSINESS(DS MYANMAR)

|     |                      |      |                                                                      |
|-----|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 기업명 | DS Myanmar Co., Ltd. | 사업분야 | 제련 사업(Solder Ball, Paste 원재료 등)                                      |
| 자본금 | 12 Million USD       | 주소   | Lot No.BL-1, Industrial Area Zone B,<br>Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar |
| 설립일 | 2019년 6월             |      |                                                                      |

## 제련사업

### 솔더볼의 원재료(주석) 등의 비철금속 제련사업

- 미얀마 양곤 위치(필라와 공단)
- 주괴, 주석합금, 기타 원재료(비철금속 등)
- 생산능력 : 150 ton/mon(추후 증설 예정)
- 2021. 2H 시가동 시작(21.4Q 매출발생)

#### □ 제련



#### □ 전해정련



#### □ 주석제품 등



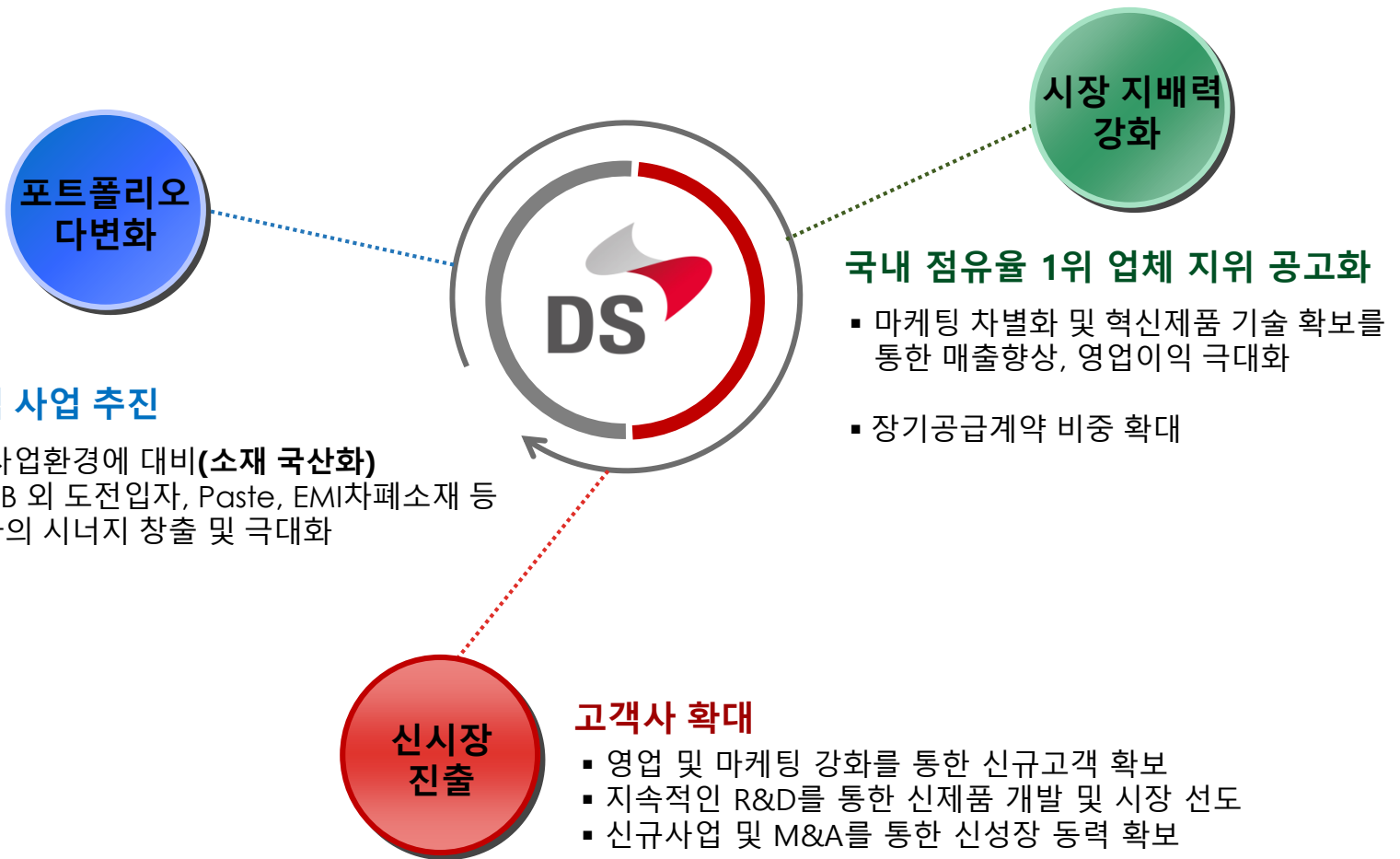
## 공장 전경





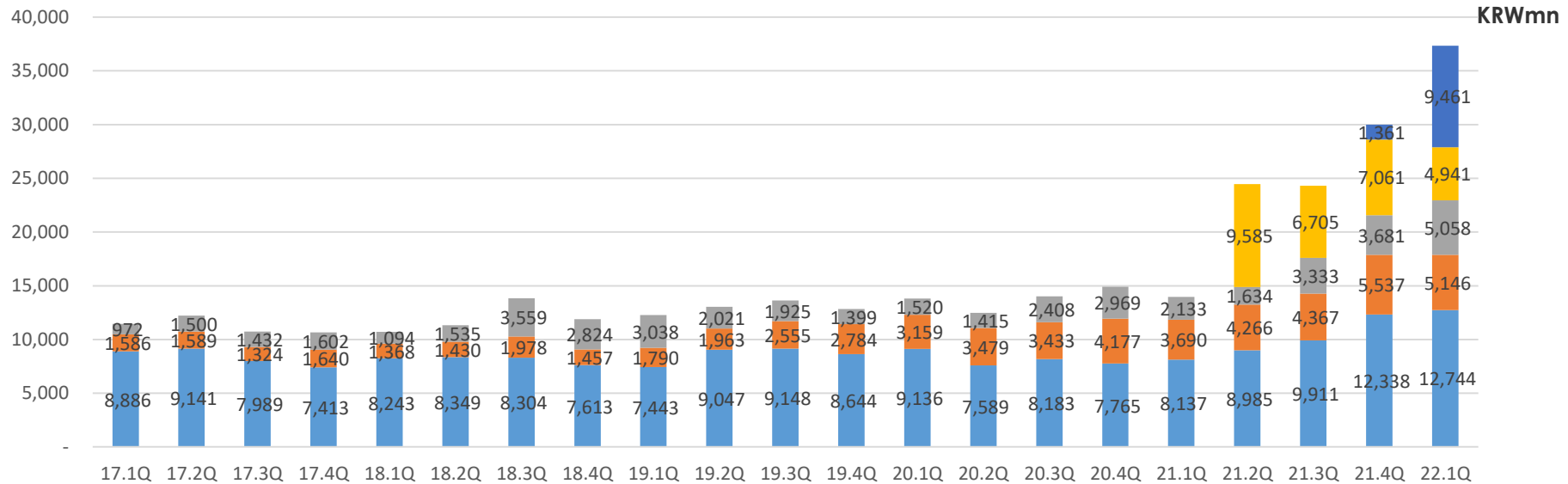
# 14. GROWTH STRATEGY

## Growth Strategy





# 15. 제품군 매출 추이



솔더볼군 : SB, MSB, CSB

비솔더볼군 : CP, Paste &amp; Flux, Powder, EMI차폐소재 등 SB MSB 비솔더볼군 덕산넵코어스 DS Myanmar

덕산넵코어스 : 방산, 항법, 민수 등

DS Myanmar : 주식 등 제련사업

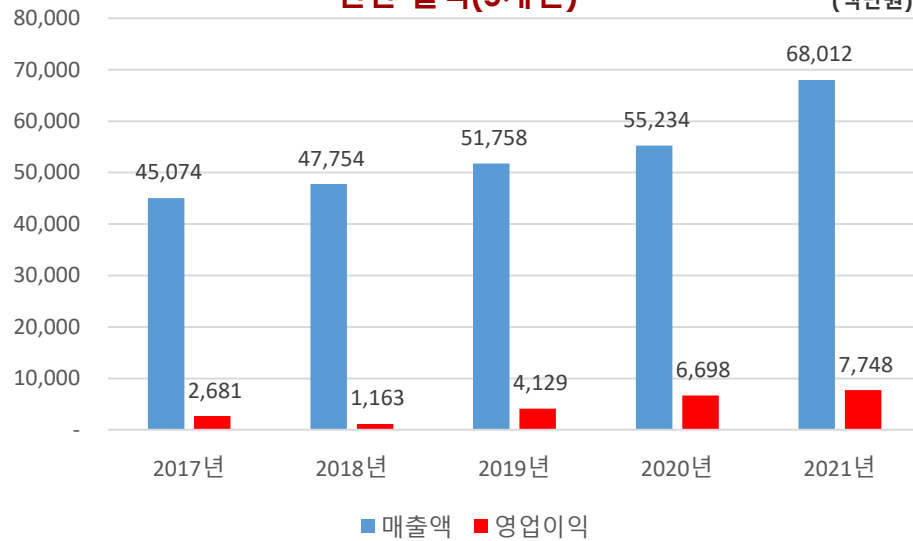
KRWmn

|       | 17.1Q  | 17.2Q  | 17.3Q  | 17.4Q  | 18.1Q  | 18.2Q  | 18.3Q  | 18.4Q  | 19.1Q  | 19.2Q  | 19.3Q  | 19.4Q  | 20.1Q  | 20.2Q  | 20.3Q  | 20.4Q  | 21.1Q  | 21.2Q  | 21.3Q  | 21.4Q  | 22.1Q  |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SB    | 8,886  | 9,141  | 7,989  | 7,413  | 8,243  | 8,349  | 8,304  | 7,613  | 7,443  | 9,047  | 9,148  | 8,644  | 9,136  | 7,589  | 8,183  | 7,765  | 8,137  | 8,985  | 9,911  | 12,338 | 12,744 |
| MSB   | 1,586  | 1,589  | 1,324  | 1,640  | 1,368  | 1,430  | 1,978  | 1,457  | 1,790  | 1,963  | 2,555  | 2,784  | 3,159  | 3,479  | 3,433  | 4,177  | 3,690  | 4,266  | 4,367  | 5,537  | 5,146  |
| 비솔더볼군 | 972    | 1,500  | 1,432  | 1,602  | 1,094  | 1,535  | 3,559  | 2,824  | 3,038  | 2,021  | 1,925  | 1,399  | 1,520  | 1,415  | 2,408  | 2,969  | 2,133  | 1,634  | 3,333  | 3,681  | 5,058  |
| 하이메탈계 | 11,445 | 12,230 | 10,745 | 10,655 | 10,705 | 11,314 | 13,841 | 11,894 | 12,271 | 13,032 | 13,628 | 12,827 | 13,816 | 12,483 | 14,024 | 14,911 | 13,960 | 14,885 | 17,610 | 21,556 | 22,947 |
| 넵코어스계 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 9,585  | 6,705  | 7,061  | 4,941  |
| 미얀마계  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1,361  | 9,461  |
| 총매출액  | 11,445 | 12,230 | 10,745 | 10,655 | 10,705 | 11,314 | 13,841 | 11,894 | 12,271 | 13,032 | 13,628 | 12,827 | 13,816 | 12,483 | 14,024 | 14,911 | 13,960 | 24,469 | 24,315 | 29,978 | 37,349 |

# 16. 연간, 분기별 실적(별도)

연간 실적(5개년)

(백만원)

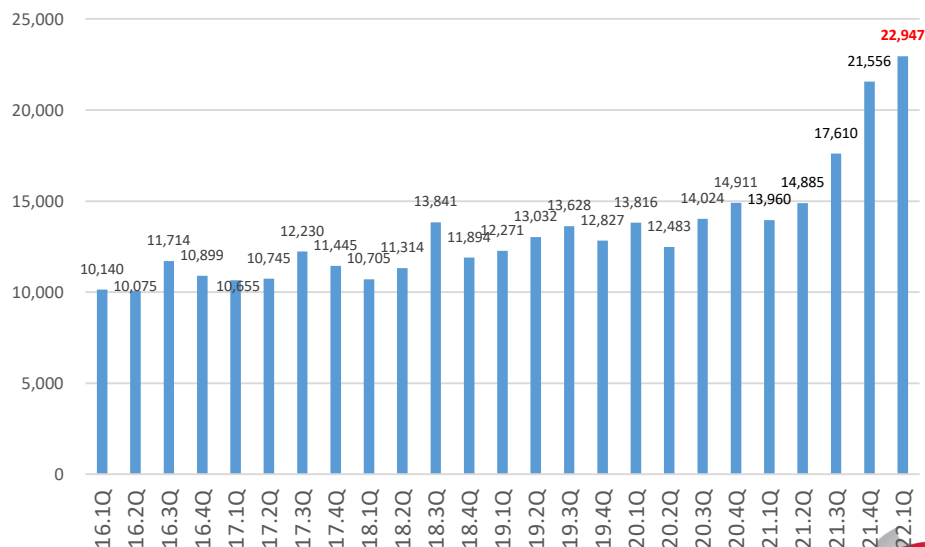


|       | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 매출액   | 45,074 | 47,754 | 51,758 | 55,234 | 68,012 |
| 영업이익  | 2,681  | 1,163  | 4,129  | 6,698  | 7,748  |
| 영업이익률 | 5.95%  | 2.44%  | 7.98%  | 12.13% | 11.39% |

■ 매출액 ■ 영업이익

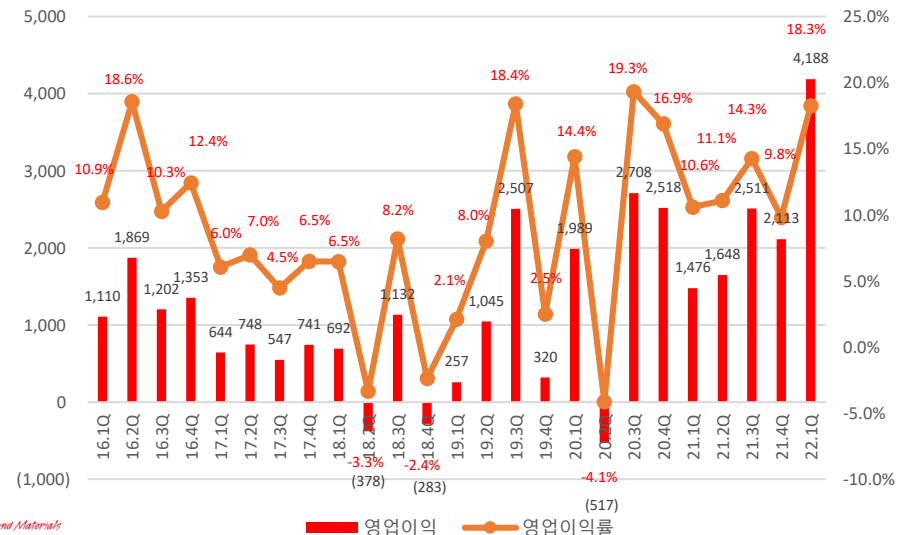
분기별 매출

KRWmn



분기별 영업이익

KRWmn



# 17. 손익, 재무상태 요약(별도)

## QoQ/YoY(별도)

KRWmn

|                | 2022<br>1Q      | QoQ   | 2021<br>4Q      | 2021<br>1Q      | YoY  |
|----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|------|
| 매출액<br>(매출원가율) | 22,947<br>(70%) | 6%    | 21,556<br>(75%) | 13,960<br>(67%) | 64%  |
| 매출총이익          | 6,931<br>(30%)  | 28%   | 5,399<br>(25%)  | 4,606<br>(33%)  | 50%  |
| 판매관리비          | 2,743<br>(12%)  | -17%  | 3,286<br>(15%)  | 3,130<br>(22%)  | -12% |
| 영업이익           | 4,188<br>(18%)  | 98%   | 2,113<br>(10%)  | 1,476<br>(11%)  | 184% |
| 영업외손익          | 563<br>(2%)     | 1100% | 47<br>(0%)      | 1,220<br>(9%)   | -54% |
| 세전이익           | 4,751<br>(21%)  | 120%  | 2,160<br>(10%)  | 2,696<br>(19%)  | 76%  |

## 재무상태표(별도)

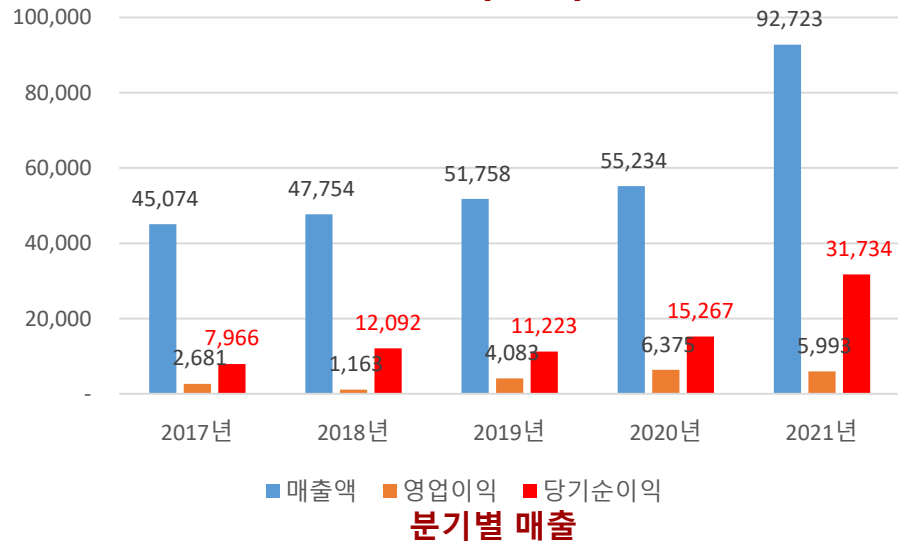
KRWmn

|             | 2022. 03. 31 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| [유동자산]      | 64,064       | 42,801       | 53,509       | 56,590       |
| [비유동자산]     | 198,344      | 197,056      | 144,743      | 134,094      |
| 자산총계        | 262,408      | 239,958      | 198,252      | 190,684      |
| [유동부채]      | 14,624       | 24,273       | 8,341        | 8,280        |
| [비유동부채]     | 2,644        | 2,130        | 2,336        | 1,901        |
| 부채총계        | 17,268       | 26,403       | 10,677       | 10,181       |
| [자본금]       | 4,544        | 4,544        | 4,544        | 4,544        |
| [주식발행초과금]   | 94,745       | 94,745       | 94,745       | 94,745       |
| [기타포괄손익누계액] |              |              |              |              |
| [기타자본항목]    | (51,080)     | (78,014)     | (91,450)     | (91,254)     |
| [이익잉여금]     | 196,932      | 192,180      | 179,736      | 172,468      |
| [비지배지분]     |              |              |              |              |
| 자본총계        | 245,140      | 213,454      | 187,575      | 180,503      |
| 부채 및 자본총계   | 262,408      | 239,858      | 198,252      | 190,684      |

# 18. 연간, 분기별 실적(연결)

연간 실적(5개년)

KRWmn

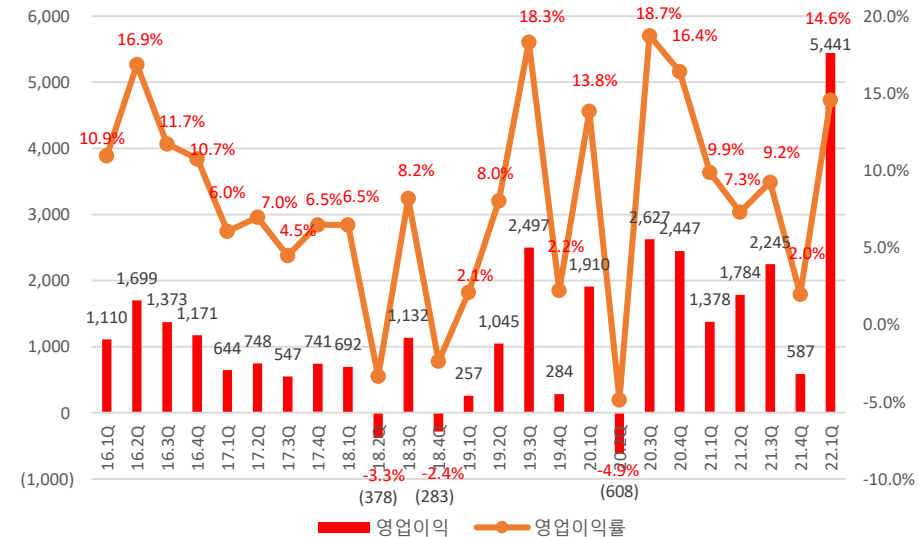
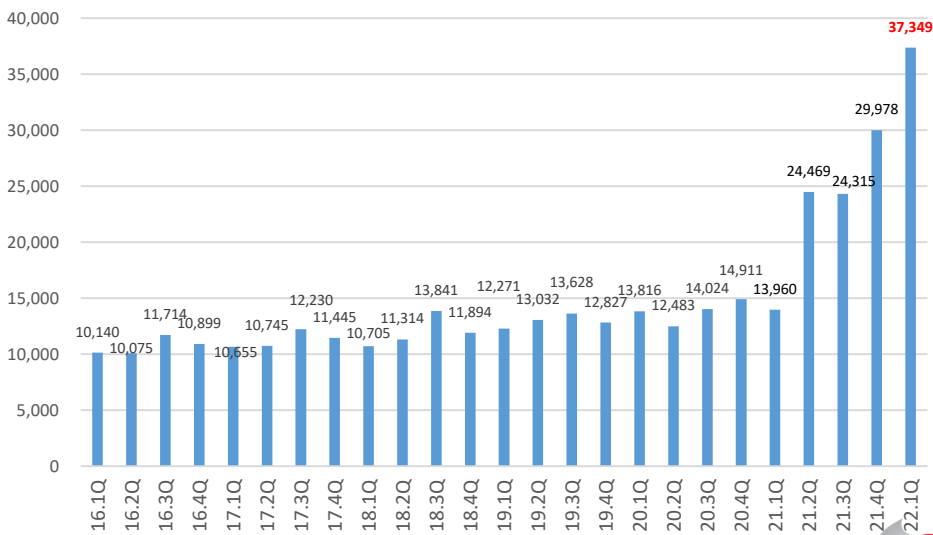


|        | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 매출액    | 45,074 | 47,754 | 51,758 | 55,234 | 92,723 |
| 영업이익   | 2,681  | 1,163  | 4,072  | 6,376  | 5,993  |
| 영업이익률  | 5.95%  | 2.44%  | 7.87%  | 11.54% | 6.46%  |
| 당기순이익  | 7,966  | 12,092 | 11,223 | 15,267 | 31,734 |
| 당기순이익률 | 17.67% | 25.32% | 21.68% | 27.64% | 34.22% |

분기별 영업이익

KRWmn

KRWmn



# 19. 손익, 재무상태 요약(연결)

## QoQ/YoY(연결)

KRWmn

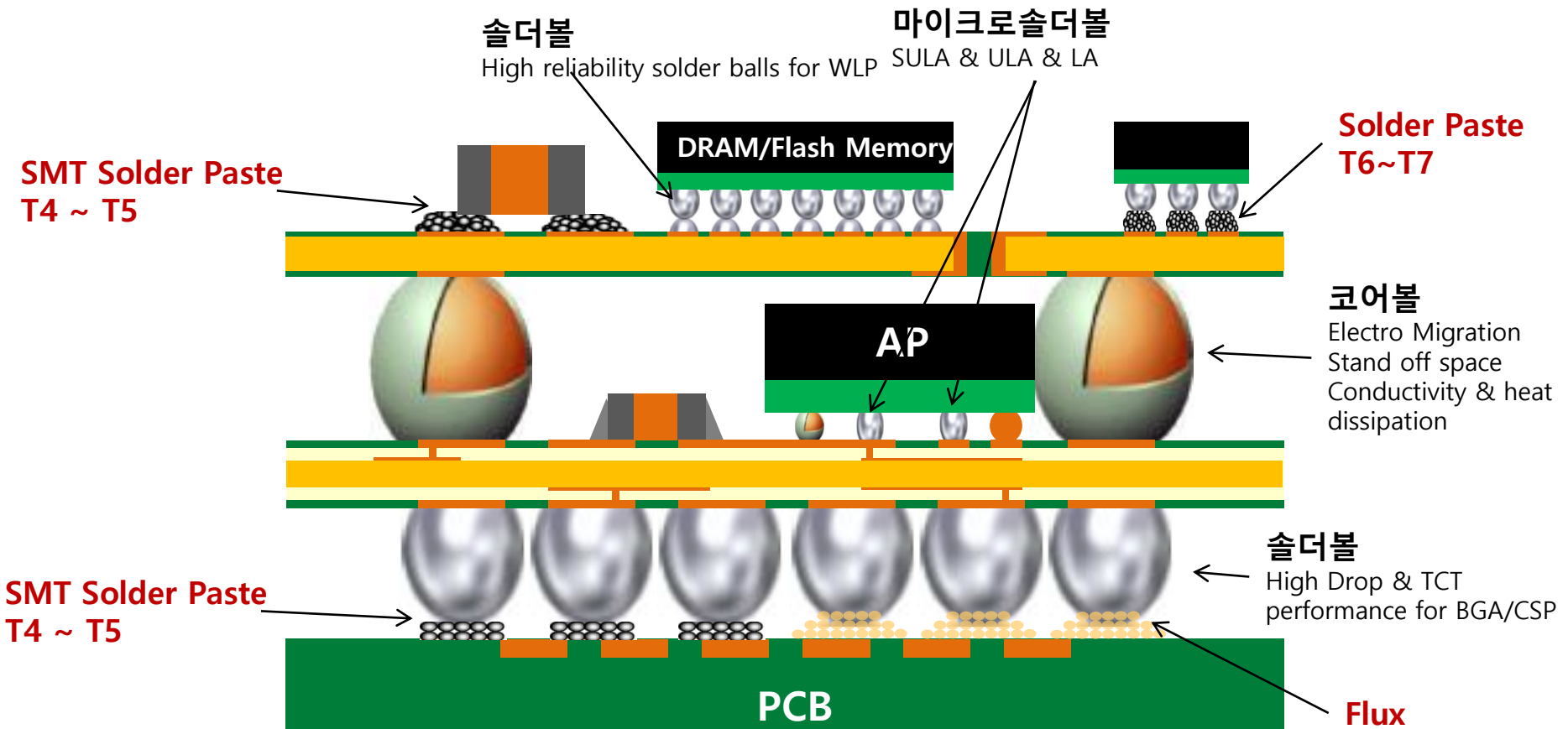
|                | 2022<br>1Q      | QoQ  | 2021<br>4Q      | 2021<br>1Q      | YoY  |
|----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|
| 매출액<br>(매출원가율) | 37,349<br>(74%) | 25%  | 29,978<br>(79%) | 13,960<br>(67%) | 168% |
| 매출총이익          | 9,883<br>(26%)  | 56%  | 6,317<br>(21%)  | 4,606<br>(33%)  | 115% |
| 판매관리비          | 4,442<br>(12%)  | -22% | 5,730<br>(19%)  | 3,228<br>(23%)  | 38%  |
| 영업이익           | 5,441<br>(15%)  | 827% | 587<br>(2%)     | 1,378<br>(10%)  | 295% |
| 영업외손익          | 4,739<br>(13%)  | -71% | 16,594<br>(55%) | 5,896<br>(42%)  | -20% |
| 세전이익           | 10,179<br>(27%) | -38% | 16,405<br>(55%) | 7,274<br>(52%)  | 40%  |

## 재무상태표(연결)

KRWmn

|             | 2022. 03. 31 | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 | 2019. 12. 31 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| [유동자산]      | 113,968      | 81,704       | 56,207       | 58,239       |
| [비유동자산]     | 244,684      | 241,966      | 173,841      | 151,930      |
| 자산총계        | 358,652      | 323,669      | 230,048      | 210,169      |
| [유동부채]      | 33,946       | 37,578       | 9,188        | 8,281        |
| [비유동부채]     | 15,377       | 13,664       | 5,916        | 1,901        |
| 부채총계        | 49,323       | 51,242       | 15,104       | 10,182       |
| [자본금]       | 4,544        | 4,544        | 4,544        | 4,544        |
| [주식발행초과금]   | 94,745       | 94,745       | 94,745       | 94,745       |
| [기타포괄손익누계액] | (2,313)      | (2,487)      | (283)        | 44           |
| [기타자본항목]    | (50,299)     | (77,233)     | (91,463)     | (91,267)     |
| [이익잉여금]     | 252,310      | 242,332      | 209,706      | 194,225      |
| [비지배지분]     | 10,341       | 10,526       | (2,305)      | (2,304)      |
| 자본총계        | 309,329      | 272,427      | 214,944      | 199,987      |
| 부채 및 자본총계   | 358,652      | 323,669      | 230,048      | 210,169      |

# 20. APPENDIX





# Thank you!